

适用于芯片、MELF、引线电容之测包机



- 对应CE安全规范
- 搭载接触检知(CONTACT CHECK)功能
- 测定时间:1.2msec
- 微小电容到大电容广泛范围的测定档位(20pF~200 μ F Range)
- 测定频率:1kHz±0.1% (正弦波形)
- 五端点测量方式
- 搭载微处理器输出 HI/GO/LO
- 3位半(1999)数字显示
- 选配GP-IB或RS-232C(OPTION)
- 搭载打印机输出(搭载Centronics)
- 即使测定中也可输出测定值、 $\delta$ 、 $3\delta$ 、mas.、min.、日期、时间等数值至打印机

## Specifications

测定范围及准确度(周围温度23°C±5°C)※D<0.1 并联等价回路

测定档位	测定准确度	测定电压
20pF	±0.25% of rdg±2digit±0.01pF以内	1V
200pF		
2nF		
20nF		
200nF		
2 μ F		
20 μ F	±0.2% of rdg±2digit以内	1V以下
200 μ F		

※100 μ F以下为(±0.8% of rdg±3digit) × 测定值[ μ F]/100以内

测定方式	五端点测定方式、并联等价回路
测定频率	1kHz±0.1%、正弦波形
寄生电容补偿范围	约20pF
全核度及零点温度系数	±100ppm/°C以内
测定时间	[外部启动] 1.2msec.
	[Free Running] 5~10次/秒
比较器设定范围	HI/LO皆为1999
使用周围环境	温度:+5°C~+40°C、湿度:85%以下
电源需求	AC100V~240V切换、50/60Hz、约30VA
外观尺寸	约333(W) × 99(H) × 300(D)mm (不包含橡胶垫等凸出物。)
重量	约5.8kg

Option

● GP-IB ● RS-232C

※可选择一种上述选配功能